

## Полуавтоматическая установка монтажа кристаллов JFP Microtechnic PP 5 / PP 6

Полуавтоматическая установка монтажа кристаллов JFP Microtechnic PP 5 / PP 6

**Производитель:**

JFP Microtechnic

**Цена:**

Цена по запросу

### Описание

Универсальная, простая в использовании, эргономичная установка монтажа кристаллов. Применение — эвтектическая пайка, сортировка в пластиковую тару, модуль ультрафиолетового отверждения, пайка горячим газом, модуль ультразвуковой притирки, монтаж лазерных и оптических компонентов.

Эргономичная концепция JFP состоит в использовании вместо микроскопа, имеющего ряд недостатков, видеосистемы со строго вертикальной оптической осью. Глаза оператора не устают, процесс монтажа и оптическая инспекция проходят гораздо более эффективно благодаря изменяемому коэффициенту увеличения. Точность позиционирования достигается с помощью цифрового генератора перекрестия и контура. Процесс монтажа кристаллов может быть выполнен в ручном или полуавтоматическом режиме. Все важнейшие параметры процесса (давление, длительность прижима) могут быть запрограммированы и сохранены в управляющем контроллере. Установка может комплектоваться любым набором вспомогательных модулей для выполнения различных методик монтажа кристаллов. Это делает ее универсальным инструментом для мелкосерийного производства, научно-исследовательских организаций и институтов.

Управление установкой PP 5 производится при помощи контроллера, а установкой PP 6 — при помощи компьютера со специальным программным обеспечением

### Варианты оснащения:

- Модуль подкола кристалла с пленочного носителя.
- Модуль штемпелевания клея.
- Модуль ультрафиолетового отверждения адгезива.
- Модуль эвтектического нагрева в инертном газе, цифровой контроллер нагрева.

- Система пайки нагретым газом через сопло.
- Модуль дозирования адгезива из шприца.
- Флип-чип-модуль с камерой, направленной вверх.
- Ультразвуковой модуль для прецизионного притирания кристалла.
- Автоматизация процесса циклического нагрева через подключение ПК.

## Технические характеристики

Рабочее поле	240×90 мм
Шаг перемещения по осям X/Y	1 мкм
Точность позиционирования	5 мкм
Размер кристаллов	min 150×150 мкм max 50×50 мм
Тип носителей кристаллов	пластиковая тара waffle-pack; гелевая упаковка gel-pack; пленка-носитель на пальцах или рамке до 200 мм
Размер корпуса или подложки	max 150×500 мм, керамика, печатная плата или корпус
Тип прижима корпуса на рабочем столе	вакуумный или механический
Программируемые параметры	давление при монтаже 0–3000 гс; длительность прижима 0–999 с; нагрев подложки до +450 °С (стандарт — 8 °С/с, опция — 50 °С/с) ввод и запоминание 1 или 2 реперных точек режим индекса с заданием шага по X/Y
Видеосистема	ПЗС-камера высокого разрешения; регулируемое увеличение
Габаритные размеры	750×700×600 мм, высота на станине — 1300 мм
Масса	60 кг
Питание	220 В/50 Гц, 500 Вт
Сжатый воздух	5 бар
Вакуум	0,3 бар, 10 л/мин